

Presseinformation

Viscom zeigt auf der electronica die Vorteile der 3D-Bondinspektion

Hannover, November 2018 – electronica, Halle A3, Stand Nr. 642 – Mit einer breiten Auswahl an Inspektionssystemen und Kameramodulen bietet die Viscom AG bereits seit vielen Jahren erstklassige Lösungen für die schnelle und hochgenaue Drahtbondfertigungskontrolle. Auf der Fachmesse electronica vom 13. bis 16. November in München können Besucherinnen und Besucher live sehen, welchen Beitrag zur Produktqualität in diesem Bereich speziell die 3D-Vermessung leisten kann.

Was bei Viscom in den Bereichen optische Inspektion und Röntgenprüfung längst Standard ist, bahnt sich nun seinen Weg auch in der Qualitätssicherung von Drahtverbindungen (Bonds): 3D-Verfahren, mit denen sich in diesem Fall z. B. sehr genau Loop-Höhen ermitteln lassen. Um auf dem electronica-Messestand von Viscom zum ersten Mal zu demonstrieren, wie bei diesen Produkten 3D-Messergebnisse zur besseren Fehlerkontrolle beitragen, wurde in Hannover eine Maschine des vielfältig konfigurierbaren Typs S6056BO mit einem neuen Kameramodul ausgestattet. Speziell auf die Anforderungen in der Drahtbondinspektion ausgelegt, basiert es auf den technologisch bewährten 3D-AOI-Modulen XM und XMplus, die weltweit sehr erfolgreich z. B. in den Systemen S3088 *ultra gold* und S3088 *ultra chrome* eingesetzt werden.

Bonds findet man z. B. als Stromverbinder in der Leistungselektronik. Damit sind sie auch bei den sich immer weiter entwickelnden Speicherbatterien für die Elektromobilität nicht wegzudenken. Da die Qualität gerade hier besonders sicherheitsrelevant ist, sind in der Fertigung hohe Anforderungen an eine rundum verlässliche Kontrolle gestellt. Viscom punktet im Bereich der Drahtbondinspektion mit einem vielfältigen Angebot an leistungsstarker Hardware, zu der auch unterschiedliche Transportlösungen für diverse Substrate und Werkstückträger gehören,

sowie intelligenter Software mit angepassten Algorithmen für eine sichere Fehlererkennung.

Bildunterschriften:

01_3D-Ansicht von Dickdrahtbonds (DCB-Substrat), aufgenommen mit dem neuen Kameramodul von Viscom für die 3D-Bondinspektion

02_Das Bondinspektionssystem S6056BO von Viscom eignet sich ideal für hohen Durchsatz und Doppelspurbetrieb

Über Viscom

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen: <https://www.viscom.de/>